

装置紹介

■イオンミリング装置 IM4000PLUS

本イオンミリング装置は、アルゴンイオンを試料に照射したときに生じるスパッタリング現象を利用して試料表面を研磨することができます。平面ミリングモードでは、研磨加工された観察試料の表面層の除去や細かなキズ、歪の除去に威力を発揮します。断面ミリングモードでは、アルゴンイオンビームで直接断面加工することで、変形や応力のない断面が得られます。そのため、主に走査型電子顕微鏡（SEM）観察や後方散乱電子回折（EBSD）測定、エネルギー分散型X線（EDX）分析などの前処理として利用でき、非常に高品位な画像データを得ることができます。

ご入用がありましたら、装置担当（千星）までお問い合わせさせていただきますようお願いいたします。

（准教授 千星 聡）



図. イオンミリング装置（日立ハイテク, IM400PLUS）

IM4000Plus 主な仕様		
使用ガス	アルゴン	
加速電圧	最大 6 eV	
モード	平面ミリング	断面ミリング
ミリング速度	~2 $\mu\text{m}/\text{h}$	~500 $\mu\text{m}/\text{h}$
試料サイズ	$\phi 50 \times 25 \text{ mm}$	W20×D12×H7mm